



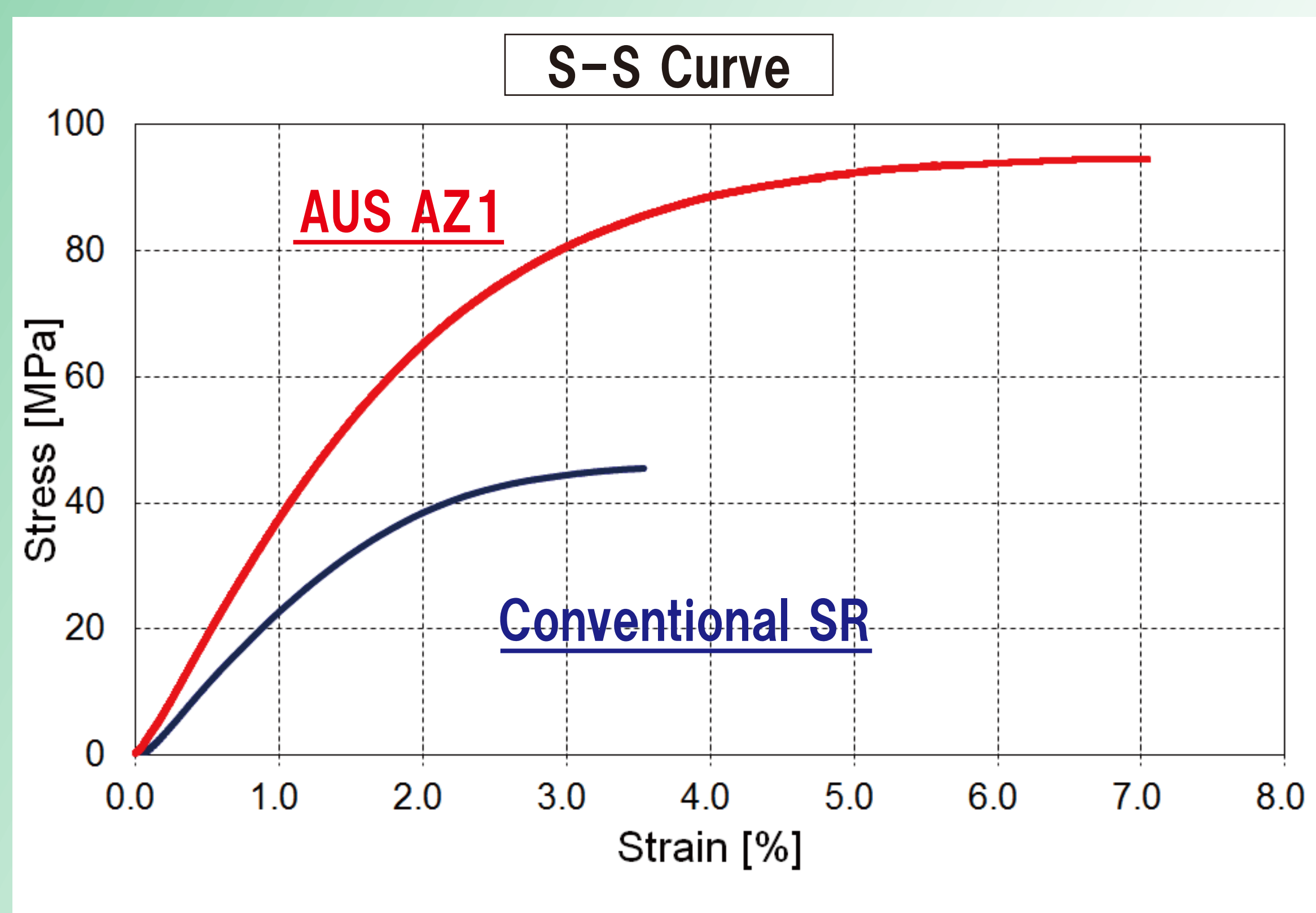
# アルカリ現像型パッケージ用ソルダーレジスト

## Photoimageable Solder Resist for IC Package Substrate Application.

### Liquid Type Solder Resist AUS AZ1 for FC-xGA (Server / Automotive 向け IC Package Substrate 対応)

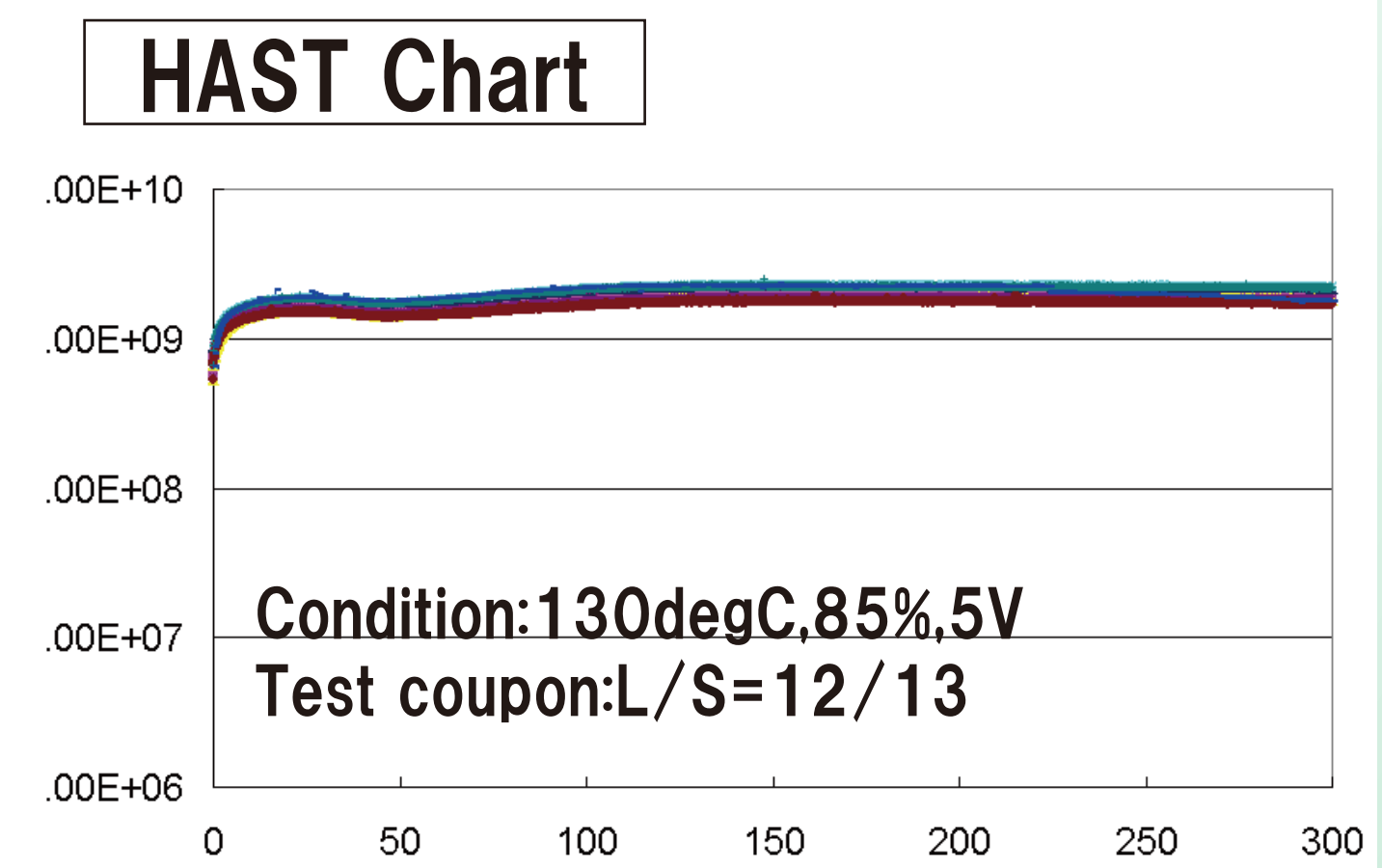
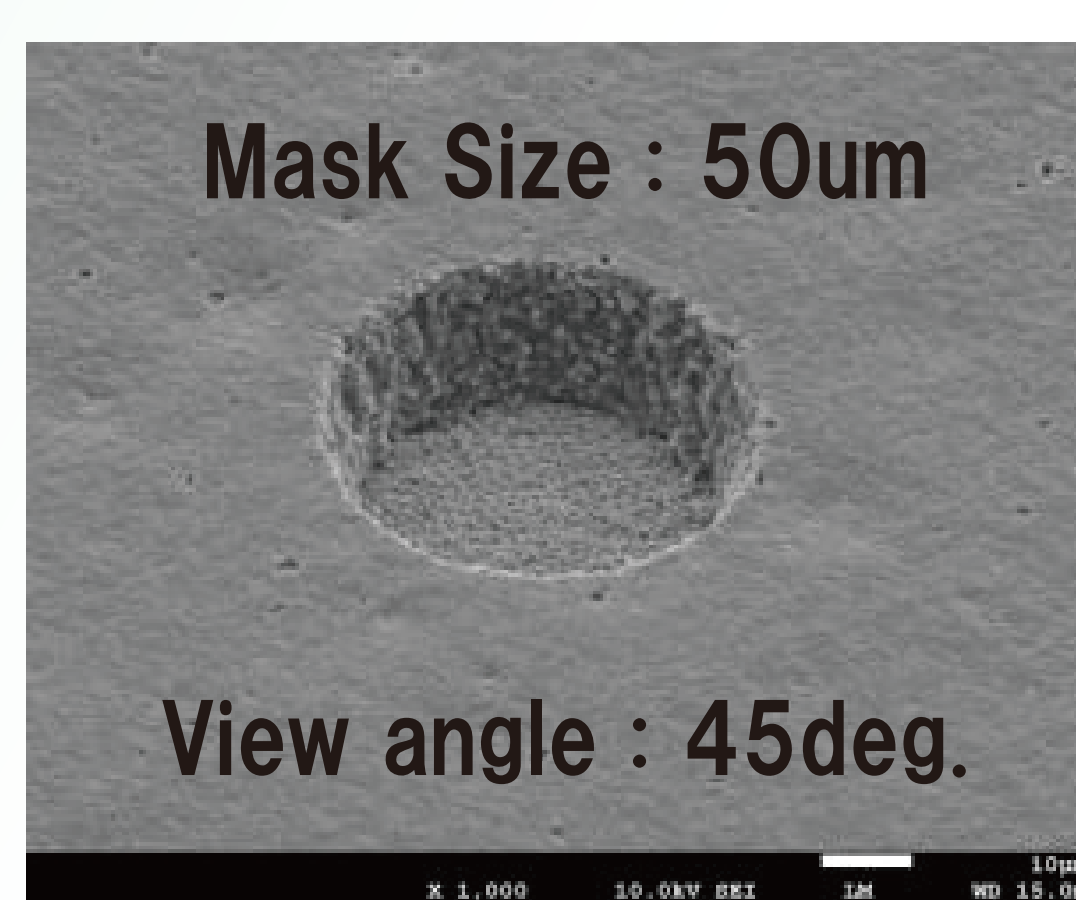
#### 特徴 Features

- 高クラック耐性 (Excellent TCT resistance)
- 高 HAST 特性 (Excellent HAST resistance)
- 優れた塗膜物性 (Excellent property)
- フィルムタイプ (AUS AZ1-F) もリリース予定



#### 特性 Properties

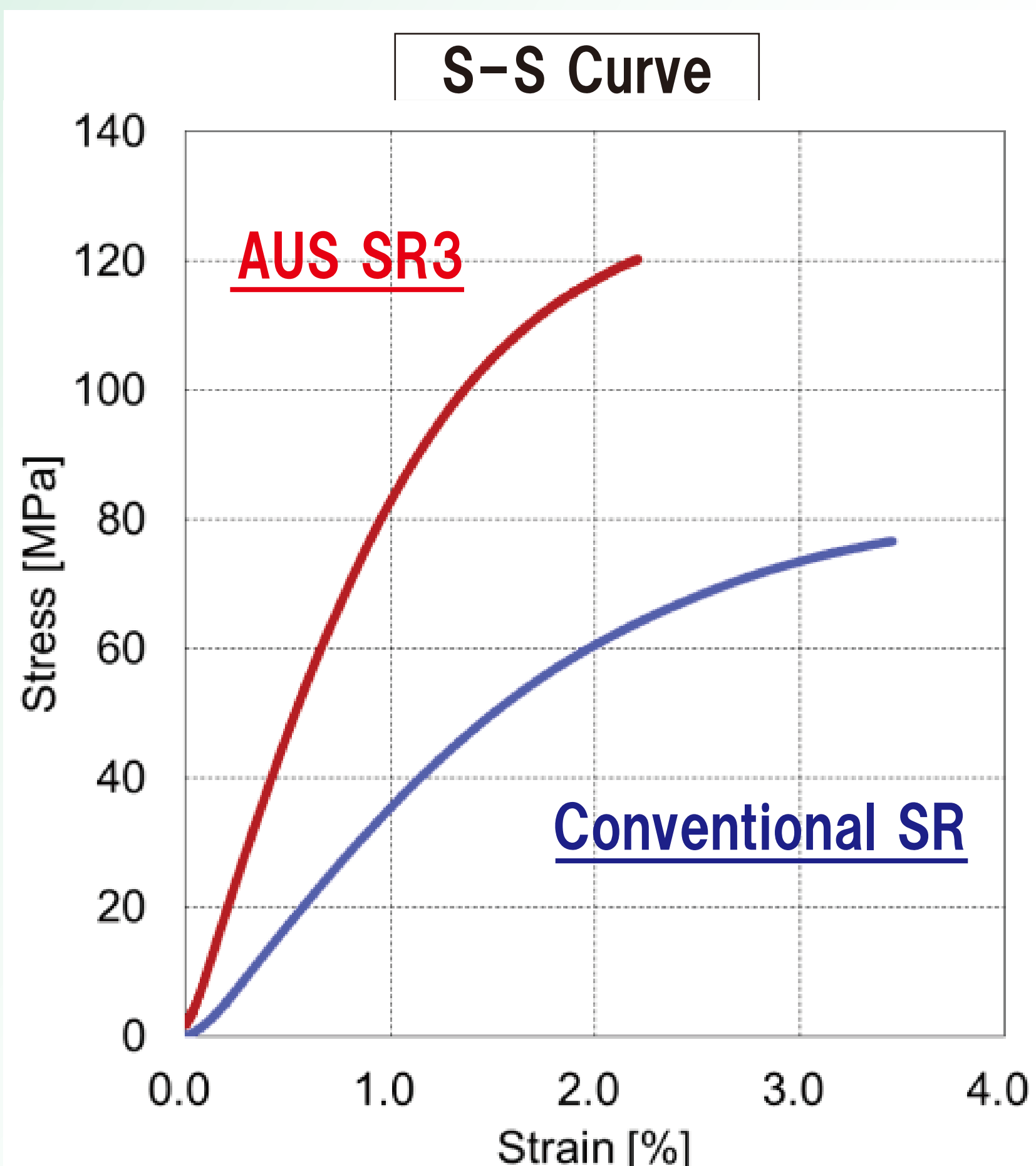
ガラス転移点 Tg *TMA method	150-160°C
線膨張係数 CTE ( $\alpha 1$ )	35-40 ppm
弾性率 Young's modulus	3.5-4.0 GPa
破壊強度 Tensile strength	90-95 MPa
破壊伸び率 Elongation	6.0-7.0%
HAST 耐性 (130°C/85%RH, 5V,L/S=12/13)	300h Pass
冷熱サイクル耐性 (150°C $\leftrightarrow$ -65°C)	1000cycle Pass



### Dry Film Type Solder Resist AUS SR3 for FC-CSP, Memory (極薄コア / コアレス向け IC Package Substrate 対応)

#### 特徴 Features

- 高弾性率 / 高強度 (High modulus & strength)
- 高 Tg / 低 CTE (High Tg / Low CTE)
- 優れた HAST 耐性 (High HAST Resistance)



#### 特性 Properties

ガラス転移点 Tg *TMA method	150-160°C
線膨張係数 CTE ( $\alpha 1$ )	15-20 ppm
弾性率 Young's modulus	9.0-10.0 GPa
破壊強度 Tensile strength	90-100 MPa
破壊伸び率 Elongation	2.0-3.0%
HAST 耐性 (130°C/85%RH, 5V,L/S=12/13)	300h Pass

